

# SMART DIASPORA 2023

**Luni, 10 aprilie 2023**

**Locație:** Opera Națională Română, Piața Victoriei, Timișoara

16:00 – 17:00	Acces eveniment
18:00 – 20:00	Deschiderea festivă în Sala Operei
20:00 – 22:00	Eveniment de networking

**WORKSHOP - Orizonturi tehnologice în micro și nanoelectronică. Contribuția diasporei la integrarea României în proiectele internaționale în domeniu - IPCEI, PNRR, CHIPS ACT**

**Marti, 11 aprilie 2023**

**Locație** Centrul de conferințe UPT, Bulevard Vasile Parvan 2B, Sala Auditorium

08:00- 08:20	Înregistrarea participanților
08:20-08:40	Deschidere, Mesaj de bun venit Moderatori: Prof. Gheorghe Ștefan, Prof. Paul Svasta, Prof. Dan Lascu
8:40 – 10:00	<p><b>Sesiunea 1 - Participarea României în programele de inovare tehnologică europene și mecanismele de sprijin financiar (IPCEI ME/CT, Chips Act, PNRR)</b></p> <p>1. <i>Colaborarea pan-europeană în programele inovative bazate pe semiconductoare</i> Jo De Boeck, Chief Strategy Officer (CSO) and Executive VicePresident - IMEC Q&amp;A, rundă de discuții</p> <p>2. <i>Inițiativele europene și mecanismele de sprijin financiar: Chips Act, PNRR și IPCEI</i> Daniel Bucur, Ministerul Economiei Q&amp;A, rundă de discuții</p> <p>3. <i>KDT JU - Menținerea Europei în avanpostul dezvoltării tehnologice</i> Simona Rucăreanu, KDT JU, Bruxelles Q&amp;A, rundă de discuții</p> <p>4. <i>Centrul de sprijin pentru cooperare europeană în micro-nanotehnologii (CESMIN) - Facilitator pentru Cooperarea Științifică în UE</i></p>

	Carmen Moldovan, IMT, Romania Q&A, rundă de discuții
10:00 – 11:00	<p><b>Sesiunea 2 - La limitele miniaturizării. Analize și metrologie la nivel nanometric.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Hub metrologic pentru arhitecturi semiconductoare de vârf</i> Marius Enăchescu, UPB Q&amp;A, rundă de discuții</li> <li>2. <i>Proiectarea pe baza Spintronic pentru emularea Brain Computing</i> Lorena Anghel, Grenoble Institute of Management and Technology Q&amp;A, rundă de discuții</li> <li>3. <i>Sinteza și caracterizarea nanostructurilor semiconductoare pentru nanoelectronica</i> Constantin Moise, UPB Q&amp;A, rundă de discuții</li> </ol>
11:00 – 11:30	<i>Pauză de cafea</i>
11:30 – 13:00	<p><b>Sesiunea 3 - Semiconductoare cu bandă interzisă largă: dispozitive și circuite</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Dezvoltări în aplicațiile complexe de temperatură ridicată ale dispozitivelor cu carbură de siliciu</i> Viorel Banu, CNM-IMB CSIC Barcelona Q&amp;A, rundă de discuții</li> <li>2. <i>Tehnologie integrată dezvoltată în carbură de siliciu și în alți semiconductori cu bandă interzisă largă pentru condiții solicitante din electronica de putere, senzori și dispozitive cuantice</i> Mihai Lazăr, University of Technology of Troyes, Troyes, France Q&amp;A, rundă de discuții</li> <li>3. <i>Diode cu carbură de siliciu cu contact Schottky neuniform pentru senzori de înaltă temperatură</i> Gheorghe Brezeanu, UPB; Gheorghe Pristavu, UPB Q&amp;A, rundă de discuții</li> <li>4. <i>Caracterizarea la temperatură ridicată a senzorilor cu carbură de siliciu</i> Florin Drăghici, UPB; Florin Mitu, UPB Q&amp;A, rundă de discuții</li> </ol>
13:00 – 15:00	<i>Pauză de prânz, Restaurantul Studențesc Politehnica Alea FC Ripensia nr 3</i>
15:00 – 16:30	<p><b>Sesiunea 4 - Sisteme ciber-fizice, MEMS și alți senzori</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>RFID Computațional</i> Mircea Stan, University of Virginia, USA Q&amp;A, rundă de discuții</li> <li>2. <i>Giroscop MEMS de înaltă stabilitate cu amplificare mecanică</i> Daniel Lăpădatu, Alfa Rom, Romania</li> </ol>

	<p>Q&amp;A, rundă de discuții</p> <p>3. <i>Senzori SAW pe safir cu nitrură de galiu/carbură de siliciu</i> Alexandru Müller, IMT, Romania Q&amp;A, rundă de discuții</p> <p>4. <i>Tehnologii de senzori și calcul bioinspirate pentru aplicații de IoT inteligente</i> Adrian M. Ionescu, EPFL, Lausanne, Switzerland Q&amp;A, rundă de discuții</p>
16:30 – 17:00	<i>Pauză de cafea</i>
17:00 – 18:30	<p><b>Sesiunea 5 - Dezvoltarea tehnologiilor digitale integrate prin sisteme inteligente inovative pentru cetățeni și comunități</b></p> <p>1. <i>Tehnologii bazate pe inteligență artificială (AI) și Internet of Things (IoT) pentru îmbunătățirea accesului la asistență medicală în comunitățile defavorizate</i> Emanuel Popovici, Electrical and Electronic Engineering, University College Cork Q&amp;A, rundă de discuții</p> <p>2. <i>Sisteme inteligente pentru monitorizarea mediului și aplicații biomedicale</i> Carmen Moldovan, IMT, Romania Q&amp;A, rundă de discuții</p> <p>3. <i>Nanomaterialele care permit colectarea inteligentă a energiei pentru viitoarea generație IoT</i> Mircea Modreanu, Tyndall National Institute, University College Cork Q&amp;A, rundă de discuții</p>
19:30 – 21:00	<p><i>Cină / Eveniment comun de networking pentru toți participanții</i> <i>Restaurantul Studențesc Politehnica</i> <i>Aleea FC Ripensia nr 3</i></p>

### **Miercuri, 12 aprilie 2023**

**Locație Centrul de conferințe UPT, Bulevard Vasile Parvan 2B, Sala Auditorium**

9:00 – 11:00	<p><b>Sesiunea 6 - Inovații la frontiera dintre chip și asamblare. Chiplet</b></p> <p>1. <i>Automobilul definit software și efectele asupra arhitecturii vehiculului</i> Christian von Albrichsfeld, Continental Automotive Q&amp;A, rundă de discuții</p> <p>2. <i>Dincolo de Legea lui Moore: tehnologii de packaging electronic avansate</i> Cătălin Ciobanu, UTBv Q&amp;A, rundă de discuții</p> <p>3. <i>Calculul de înaltă performanță în Olanda: Prezentare generală și dezvoltări viitoare</i> Valeriu Codreanu, SURF Q&amp;A, rundă de discuții</p>
--------------	--

11:00 – 11:30	<i>Pauză de cafea</i>
11:30 – 13:45	<b>Sesiune Specială</b> organizată de Ministerul Economiei – Viziunea și așteptările României legate de programul European Chip Act
13:45-14:15	Relocare la Continental Automotive Romania, Str. Siemens No 1, Corp A Vizită exclusivă pentru diaspora, comunitatea academică și reprezentanții OCD
14:15 – 17:30	Vizită exclusivă pentru diaspora, comunitatea academică și reprezentanții OCD la Continental Automotive Romania:  14:15-14:30 Bun venit din partea echipei de management a Continental , Sala A6.153.  14:30-15:00 Prânz și socializare 30 min  15:00-16:15 Vizitarea facilităților Continental (Grupul 1 pentru C&D / Grupul 2 pentru fabrică)  Ghizi coordonatori fabrică: Lucian Mărgineanu, Petru Demian, Liviu Almăjan  16:15-17:30 Vizitarea facilităților Continental (Grupul 2 pentru C&D / Grupul 1 pentru fabrică)  Ghizi coordonatori R&D: Ciprian Bleoju, Andrei Son, Cosmin Moisa  17:30 Relocare la UPT
De la 19:30	<i>Cină/Eveniment comun de networking pentru toți participanții</i>  CRAFT - Centrul Regional de Afaceri Timișoara  Bulevardul Eroilor de la Tisa nr.22

**Joi, 13 aprilie 2023**

**Universitatea de Vest din Timișoara, Aula Magna Bd. Vasile Pârvan nr 4**

9:00 – 10:30	<b>Sesiune plenară, concluzivă</b> Universitatea de Vest din Timișoara, Aula Magna - Bd. Vasile Pârvan nr 4
10:30 – 11:00	<i>Pauză de cafea</i>
11:00 – 12:30	<b>Sesiune plenară, concluzivă</b> Universitatea de Vest din Timișoara, Aula Magna – Bd. Vasile Pârvan nr 4
13:00 – 17:00	<i>Prânz și Program turistic – Cramele RECAȘ</i>  *Plecarea la Cramele Recaș se face cu autocarul Universității Politehnica Timișoara